



達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

2022.12.13



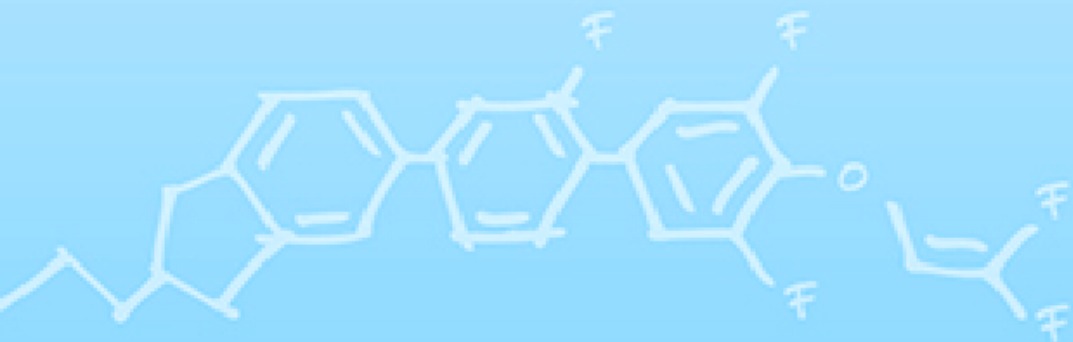
Design House for Chemical Materials

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

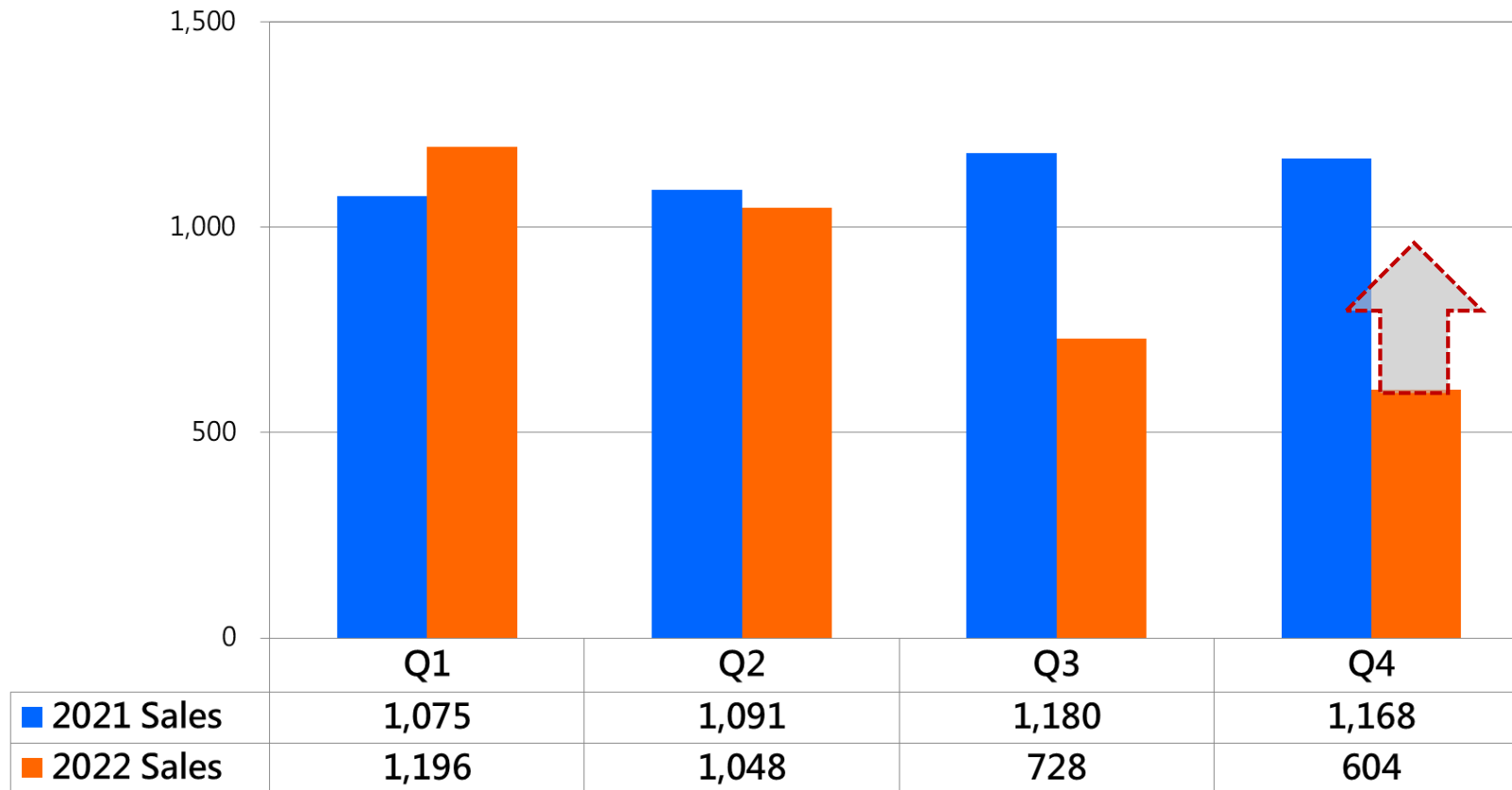
- ◆ 經營成果
- ◆ 營運概況與未來展望



經營成果

營業額

Unit: NTD M

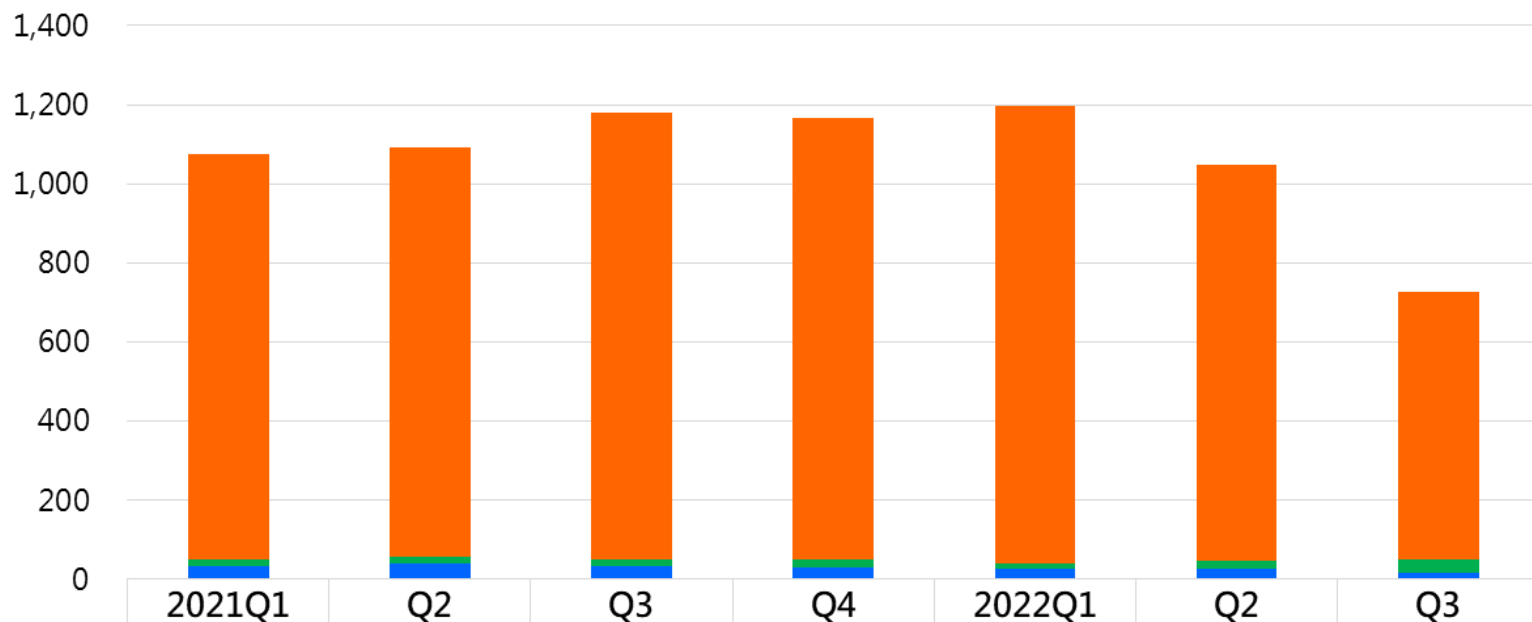


◆ 2022年 1-11月營收 3,576M，較去年同期 4,118M，減少 13.2%。

註：2022Y Q4 為 10~11月自結數

產業別營收

(NTD M)



顯示器材料	1,025.6	1,034.2	1,130.4	1,118.9	1,155.4	1,000.0	678.4
半導體材料	15.2	18.2	15.0	17.9	14.7	20.8	31.8
關鍵原材料及其他	33.8	38.6	34.7	30.9	26.2	27.3	17.4
TOTAL	1,074.6	1,091.0	1,180.1	1,167.7	1,196.3	1,048.1	727.6
半導體佔比	1.4%	1.7%	1.3%	1.5%	1.2%	2.0%	4.4%
關鍵原材料及其他佔比	3.1%	3.5%	2.9%	2.6%	2.2%	2.6%	2.4%

合併綜合損益表

Unit : NTD M

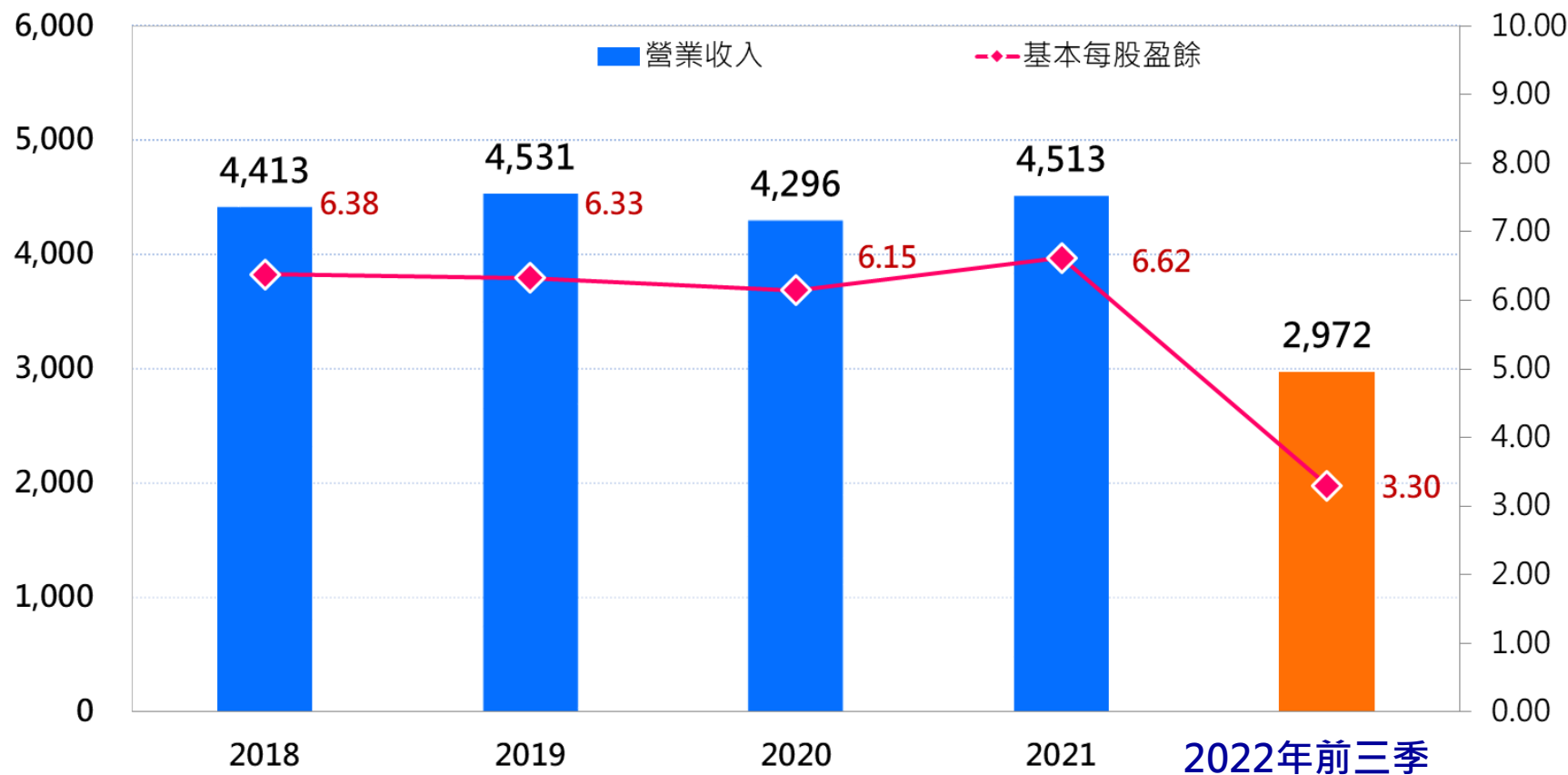
	2022 Q1		2022 Q2		2022 Q3		2022 前三季		2021 前三季		年成長%
營業收入	1,196	100.0%	1,048	100.0%	728	100.0%	2,972	100.0%	3,346	100.0%	(11.2%)
營業成本	812	67.9%	684	65.2%	530	72.8%	2,025	68.2%	2,135	63.8%	(5.1%)
營業毛利	384	32.1%	364	34.8%	198	27.2%	947	31.8%	1,211	36.2%	(21.8%)
營業費用	218	18.2%	214	20.4%	181	24.9%	613	20.6%	631	18.9%	(2.9%)
營業淨利	167	13.9%	151	14.4%	17	2.3%	334	11.2%	580	17.3%	(42.5%)
營業外收(支)	12	1.0%	13	1.3%	25	3.4%	50	1.7%	(0)	0.0%	(38686.9%)
稅前淨利	179	15.0%	164	15.6%	41	5.7%	384	12.9%	580	17.3%	(33.8%)
綜合損益總額	163	13.7%	140	13.4%	35	4.9%	339	11.4%	513	15.3%	(33.9%)
基本每股盈餘 (NTD)	1.59		1.36		0.35		3.30		4.99		

◆ 2022年 1-11月稅前淨利為 447M ，較去年同期713M ，減少 37.3% 。

營收與獲利趨勢

Unit: NTD M

Unit: NTD



PS. 2022/Q3受面板需求減緩產能下降影響，致前3季營收及獲利減幅較大。

合併資產負債表摘要



Unit: NTD M

	2022/9/30		2021/9/30		年成長	年成長 %
現金及約當現金	196	4.6%	199	4.4%	(3)	(1.5%)
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	1,033	24.4%	850	18.8%	183	21.6%
應收帳款	813	19.2%	1,304	28.8%	(490)	(37.6%)
存貨	382	9.0%	385	8.5%	(3)	(0.9%)
不動產、廠房及設備	1,576	37.2%	1,540	34.0%	37	2.4%
使用權資產	175	4.1%	182	4.0%	(7)	(3.8%)
資產總計	4,242	100.0%	4,528	100.0%	(286)	(6.3%)
流動負債	895	21.1%	1,240	27.4%	(345)	(27.8%)
非流動負債	485	11.4%	388	8.6%	97	25.1%
負債總計	1,380	32.5%	1,628	36.0%	(248)	(15.2%)
權益總計	2,862	67.5%	2,900	64.0%	(38)	(1.3%)

重要財務指標

流動比率%

276%

224%

存貨週轉天數

50

43

PS.應收帳款、流動負債應付帳款、存貨周轉天數等受面板產業需求下滑，影響產銷規模縮小、備貨減少。

合併現金流量表摘要



Unit: NTD M

2022 前三季

2021 前三季

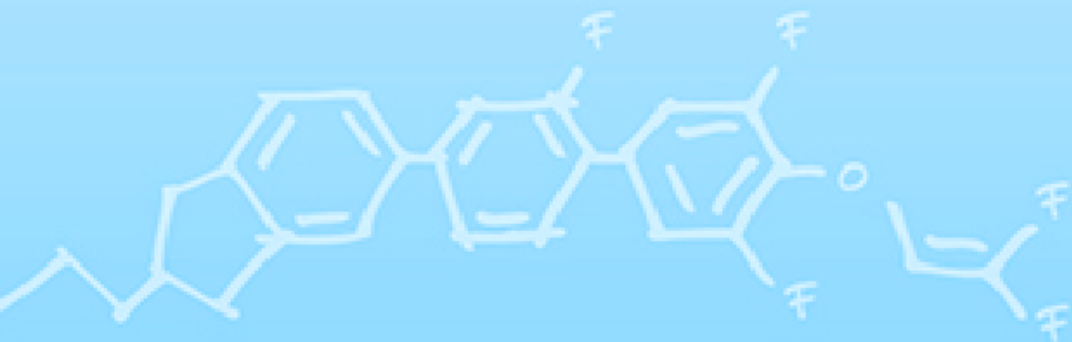
本期稅前淨利	384	580
折舊及攤銷	164	164
營運資金變動	166	(147)
營業活動之淨現金流入	623	507
取得不動產、廠房及設備	(173)	(317)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	(92)	112
投資活動之淨現金流出	(267)	(206)
舉借短期借款	120	140
償還短期借款	(120)	(60)
舉借長期借款	182	54
償還長期借款	(6)	-
發放現金股利	(544)	(514)
籌資活動之淨現金流出	(375)	(385)
本期現金及約當現金減少	(19)	(85)
期末現金及約當現金餘額	196	199

註：2022/9/30及2021/9/30期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,229M及1,040M。

股利政策

■ 維持高配息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2021	6.62	5.3	0.0	80%
2020	6.15	5.0	0.0	81%
2019	6.33	5.0	0.0	79%
2018	6.38	5.0	0.0	78%
2017	5.07	3.5	1.0	89%



營運概況與未來展望

營運據點

業務辦公室
蘇州★

業務辦公室
深圳★

先進製造中心 II – LCD材料廠



先進製造中心 II – 半導體材料廠



業務辦公室
桃園★

規劃中
高雄橋頭★

營運總部/研發中心 – 台中中科



先進製造中心 I – 台中中科

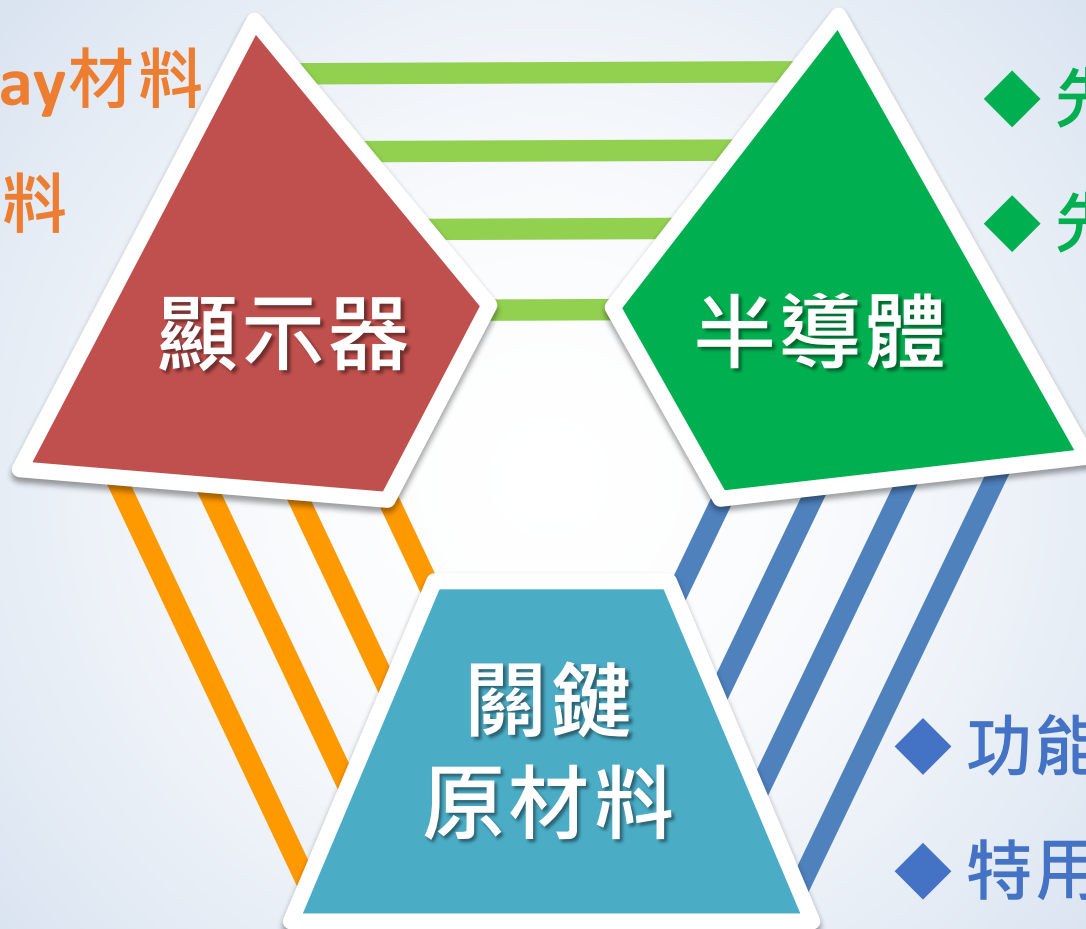


- 先進製造中心 I 及 先進製造中心 II – LCD材料廠：
分別已有 半導體產線 投入生產 半導體產品，量產出貨中。
- 先進製造中心 II – 半導體材料廠：
以半導體高純度合成、純化、配方生產線為主，預計2023/Q2加入量產。

產品佈局

◆ LCD CF/Array材料

◆ LCD Cell 材料



◆ 先進製程材料

◆ 先進封裝材料

◆ 功能性單體

◆ 特用高分子

2022經營成果



DAXiN

■ LCD Color Filter

- 感光間隙材PS : 高精細PS 新產品導入客戶新產線，保持市占領先。
- 黑色光阻BM : 高精細高阻抗BM 開發完成，驗證通過。

■ LCD Cell

- PI配向膜 : PSA PI (Polymer Stabilized Alignment) 放量導入主要面板廠，高附著規格已認證完成，2023年將擴大營收貢獻。
- 液晶LC : Monitor產品持續放量，電競應用新規格開發完成。

■ LCD Array

- 8K銅蝕刻液 : 8K產品保持市佔領先，投入開發下世代規格產品。

2022新產品開發

半導體

DAXiN

■ 先進封裝 (晶圓級/面板級)

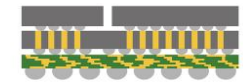
- 有機離型層：穩定量產，平行展開導入新客戶。
- 高選擇比銅蝕刻液：開發完成，上線驗證。
- 特用清洗液：特性測試，上機驗證。
- 感光介電材：客戶驗證材料特性與產品信賴性。

■ 晶圓製程 (先進製程/成熟製程)

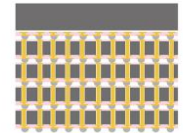
- 感光晶圓保護層：完成A世代半導體材料計畫開發。
- 光阻剝離液：二項新產品正式量產出貨。
- 高純度溶劑：穩定量產，平行展開導入新客戶。
- 光阻頂部塗層：開發完成，上線驗證。
- 特用去除液：三項新產品開發完成，上線驗證。



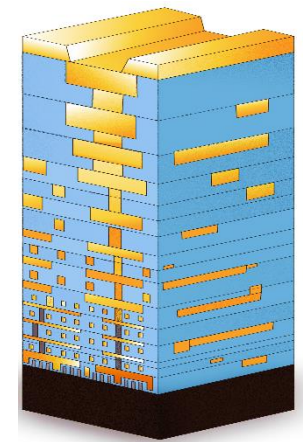
FOWLP/FOPLP



2.5D IC



3D IC



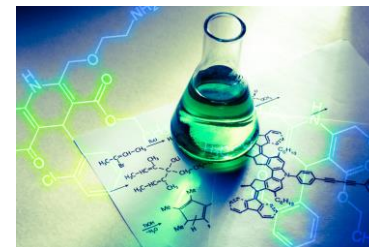
2022新產品開發

關鍵原材料

DAXiN

■ 顯示器領域

- PI(Polyimide)功能性單體：歐美日韓客戶測試驗證。
- 液晶單晶：自有專利單晶設計開發，具價格競爭力。
- 高阻抗黑色色膏：特殊色粉表面改質分散技術。



■ 半導體領域

- 無氯環氧單體：高信賴性要求之高階電子封裝材。
- 特用低離子單體：先進濕製程 高純度特用化學品。
- 高純度高分子：先進微影製程 高純度特用光阻材料。



研發計畫 - 顯示器

- 優化產品組合，強化更具競爭力之產品策略。
- 優化生產製程，掌握自製關鍵原材料，提高成本競爭力。
- 開發更高規格材料，擴大市佔率。

LCD Color Filter

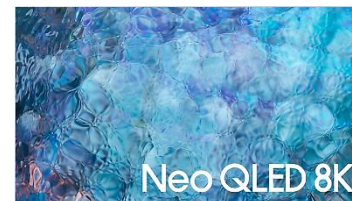
- 低溫 感光間隙材 PS
- 低溫 黑色光阻 BM

LCD Cell

- 低溫 PI配向膜
- 曲面 PI配向膜
- 高對比 快速液晶 LC

LCD Array

- 下世代8K銅蝕刻液



Source : Samsung

研發計畫 - 半導體

- 先期開發下一世代先進製程及先進封裝所需新材料。
- 與國際材料大廠及國際半導體大廠之策略合作並行。

先進封裝

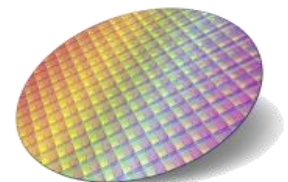
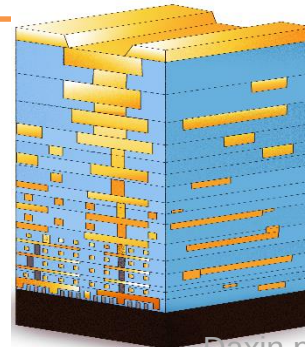
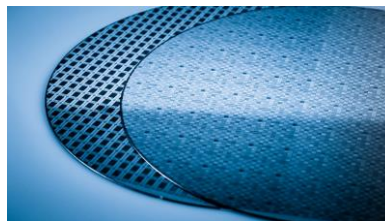
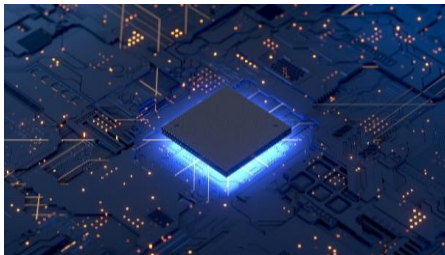
- 高解析 感光介電材
- 低溫 感光介電材

先進製程 BEOL

- 高選擇比 銅蝕刻液
- 高純度表面處理液A
- 高解析 感光晶圓保護材

先進製程 FEOL

- 特用保護框膠
- 高純度表面處理液B



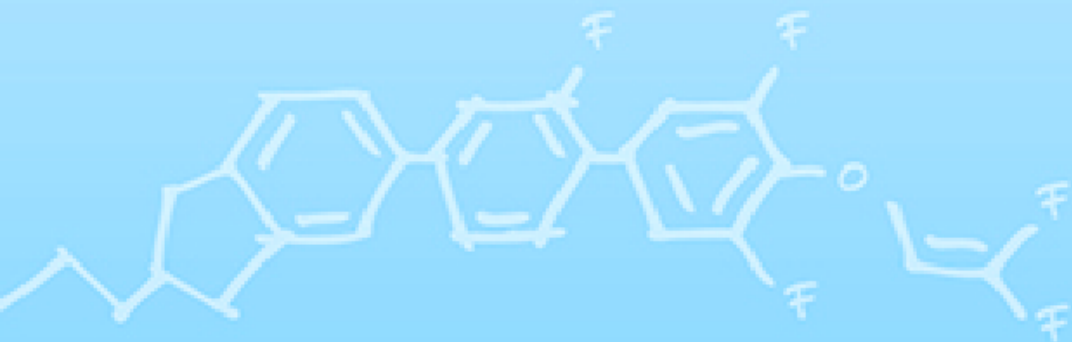
營運計畫 - 半導體

DAXIN 自主開發

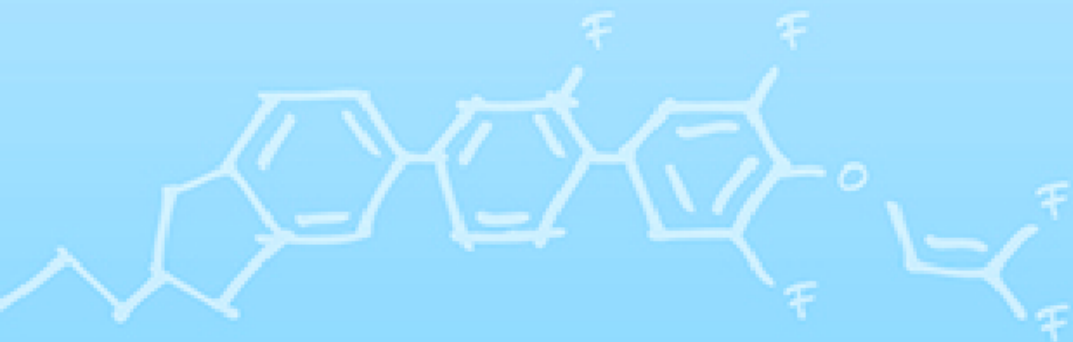
- 建構半導體高階先進材料在地化供應鏈。
- 自主供應超高純度及高品質穩定性半導體級化學品。
- 開發下一代先進製程及先進封裝所需新材料。

國際材料大廠 及 國際 半導體大廠 策略合作

- 強化高純度濕製程化學品配方純化製造與品管能力。
- 精進高純度光阻關鍵高分子合成純化製造與品管能力。
- 共同開發創新領先製程技術及特殊3D晶片所需新材料。



Q & A



Thank you